

### 1 特性

- 低噪声:  $0.77\mu\text{V}$
- 带宽:  $28\text{MHz}$
- 电源电压范围:  $2.7\text{V}$  至  $5.5\text{V}$
- 输入共模电压:  $0.3\text{V}$  至  $\text{VDD}-1\text{V}$
- 输入失调电压:  $10\mu\text{V}$
- 单位增益稳定
- 轨到轨输出
- 失调电压温漂:  $0.4\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- 工作温度范围:  $-40^\circ\text{C}$  至  $+125^\circ\text{C}$

### 2 应用领域

- 传感器
- 音频
- 精密滤波器
- PLL 滤波器
- 数字秤

### 3 管脚定义

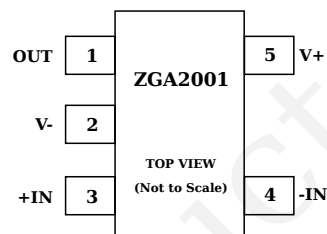


图 1: SOT23-5

### 4 综述

ZGA2001 是一款专为高精度应用设计的低噪声 CMOS 运算放大器。其卓越的低噪声特性 ( $0.1\text{Hz}$  至  $10\text{Hz}$  时仅为  $0.77\mu\text{V}$ ) 使其成为对噪声敏感应用的理想选择。ZGA2001 支持  $2.7\text{V}$  至  $5.5\text{V}$  电源供电, 确保在各种工作条件下都能提供出色的线性度和动态性能。此外, 它拥有  $28\text{MHz}$  的增益带宽积和  $10\text{V}/\mu\text{s}$  的压摆率, 能够在高频应用中保持稳定的性能表现。ZGA2001 的工作温度范围为  $-40^\circ\text{C}$  至  $+125^\circ\text{C}$ , 适用于广泛的工业和消费类电子产品。

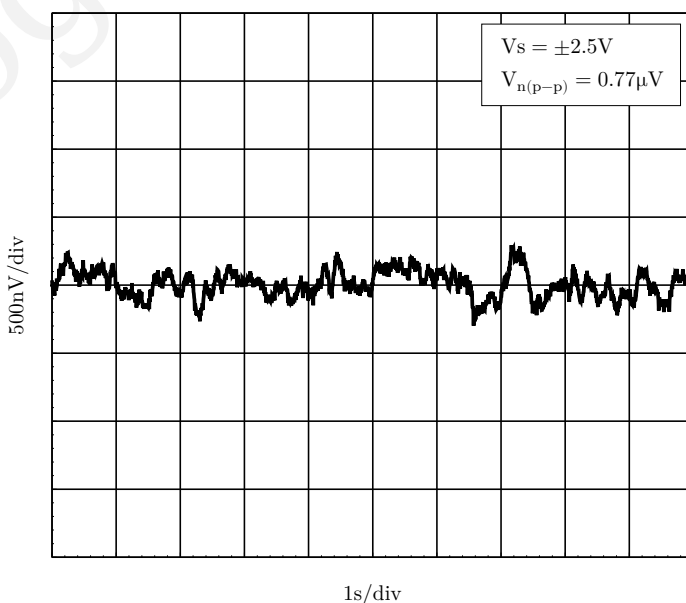


图 2: 低频噪声 ( $0.1\text{Hz}$  至  $10\text{Hz}$ )

目录

1 特性 1

2 应用领域 1

3 管脚定义 1

4 综述 1

5 性能参数 4

6 性能特性 6

7 应用信息 11

7.1 输出相位反转 11

7.2 输入电容 11

7.3 驱动容性负载 11

7.4 布局指南 12

7.5 布局示例 12

8 封装 13

9 订购指南 14

10 关于微格 15

10.1 公司简介 15

10.2 联系方式 15

插图

1 SOT23-5 1

2 低频噪声 (0.1 Hz 至 10 Hz) 1

3 性能特性 (1) 6

4 性能特性 (2) 7

5 性能特性 (3) 8

6 性能特性 (4) 9

7 性能特性 (5) 10

8 无相位反转 11

9 无补偿驱动大容性负载 11

10 缓冲器网络 11

11 使用缓冲器驱动大容性负载 11

12 布局示例 12

13 封装信息 13

表格

1 文档版本 3

2 性能参数 (1) 4

3 性能参数 (2) 5

表 1: 文档版本

版本号	说明
1.0	初版发行
1.1	更新 Vos 的测试条件
1.2	增加应用说明及 $V_s=2.7V$ 的性能特性

## 5 性能参数

测试条件:  $V_S=5V$ ,  $V_{CM}=V_S/2$ ,  $T_A=25^{\circ}C$  (除非另有说明)

表 2: 性能参数 (1)

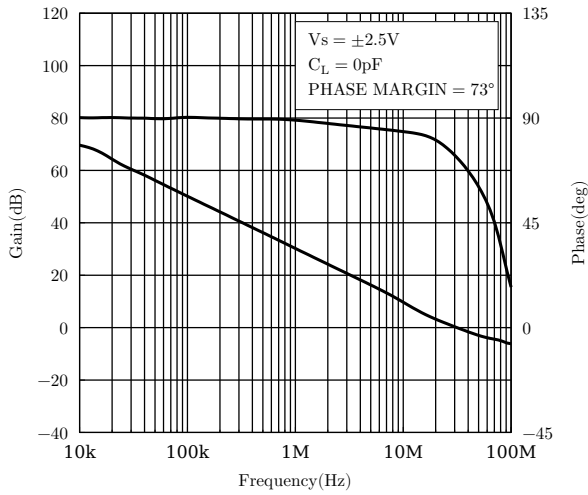
参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
输入特性						
失调电压	$V_{OS}$	$V_{CM}=2.5V$		10	30	$\mu V$
		$V_{CM}=0V$ 至 $4.0V$			30	$\mu V$
失调电压温漂	$V_{OS}/\Delta T$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		0.4	1	$\mu V/^{\circ}C$
输入偏置电流	$I_B$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		1	10	pA
输入失调电流	$I_{OS}$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$			200	pA
		$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$			10	pA
		$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$			200	pA
输入共模电压范围			0		4	V
共模抑制比	CMRR	$V_{CM}=0.1$ 至 $4V$	88	100		dB
大信号电压增益	$A_{VO}$	$V_O=0.2V$ 至 $4.8V$ , $R_L=10k\Omega$	105	110		dB
输出特性						
高输出电压	$V_{OH}$	$I_L=1mA$ ; $-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$	4.97	4.991		V
低输出电压	$V_{OL}$	$I_L=1mA$ ; $-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		5	30	mV
输出电流	$I_{OUT}$	$V_{OUT}=\pm 0.5V$		$\pm 250$		mA
电源						
电源抑制比	PSRR	$V_S=2.7V$ 至 $5V$	85	100		dB
放大器电源电流	$I_{SY}$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		4.7	5.2	mA
					7	mA
输入电容						
差分	$C_{DIFF}$			11.9		pF
共模	$C_{COM}$			13.4		pF
噪声性能						
低频噪声	$e_{n\ p-p}$	0.1 Hz 至 10Hz		0.77		$\mu V$
输入电压噪声密度	$e_n$	$f=1KHz$		3		nV/ $\sqrt{Hz}$
		$f=10KHz$		2.1		nV/ $\sqrt{Hz}$
频率响应						
增益带宽积	GBP			28		MHz
压摆率	SR	$R_L=10K\Omega$		10		V/ $\mu s$
建立时间	$t_s$	建立至 0.1%, $V_{IN}=2V_{p-p}$ step, $G=+1$		180		ns
相位裕量	$\Phi_M$	$C_L=0pF$		73		$^{\circ}$

测试条件:  $V_S=2.7V$ ,  $V_{CM}=V_S/2$ ,  $T_A=25^{\circ}C$  (除非另有说明)

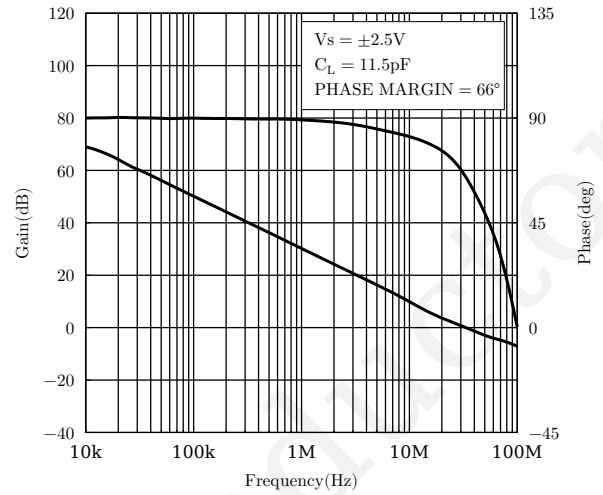
表 3: 性能参数 (2)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
输入特性						
失调电压	$V_{OS}$	$V_{CM}=1.35V$ $V_{CM}=0V$ 至 $1.7V$		10	30	$\mu V$ $\mu V$
失调电压温漂	$V_{OS}/\Delta T$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		0.4	1	$\mu V/^{\circ}C$
输入偏置电流	$I_B$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		1	10	pA
输入失调电流	$I_{OS}$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$			200	pA
输入共模电压范围					10	pA
共模抑制比	CMRR	$V_{CM}=0.1$ 至 $1.7V$			200	pA
大信号电压增益	$A_{VO}$	$V_O=0.2V$ 至 $2.5V$ , $R_L=10k\Omega$	0		1.7	V
			83	97		dB
			100			dB
输出特性						
高输出电压	$V_{OH}$	$I_L=1mA$ ; $-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$	2.67	2.688		V
低输出电压	$V_{OL}$	$I_L=1mA$ ; $-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		8	30	mV
输出电流	$I_{OUT}$	$V_{OUT}=\pm 0.5V$		$\pm 100$		mA
电源						
电源抑制比	PSRR	$V_S=2.7V$ 至 $5V$	82	97		dB
放大器电源电流	$I_{SY}$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		4.7	5.2	mA
					7	mA
输入电容						
差分	$C_{DIFF}$			11.9		pF
共模	$C_{COM}$			13.4		pF
噪声性能						
低频噪声	$e_{n\ p-p}$	0.1 Hz 至 10Hz		0.74		$\mu V$
输入电压噪声密度	$e_n$	$f=1KHz$		3		nV/ $\sqrt{Hz}$
		$f=10KHz$		2.1		nV/ $\sqrt{Hz}$
频率响应						
增益带宽积	GBP			27		MHz
压摆率	SR	$R_L=10K\Omega$		9		V/ $\mu s$
建立时间	ts	建立至 0.1%, $V_{IN}=1V_{p-p}$ step, $G=+1$		180		ns
相位裕量	$\Phi_M$	$C_L=0pF$		58		$^{\circ}$

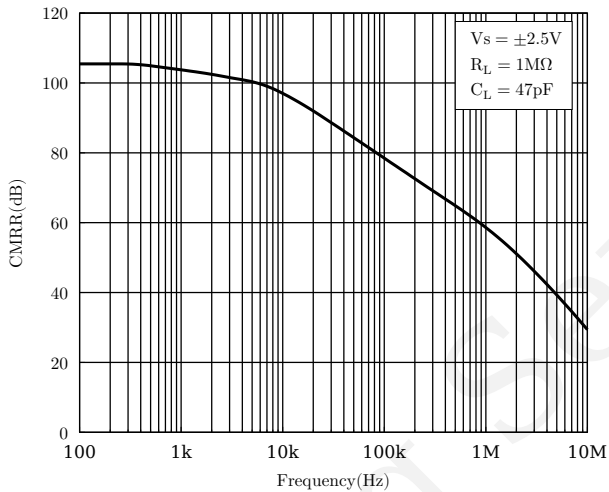
## 6 性能特性



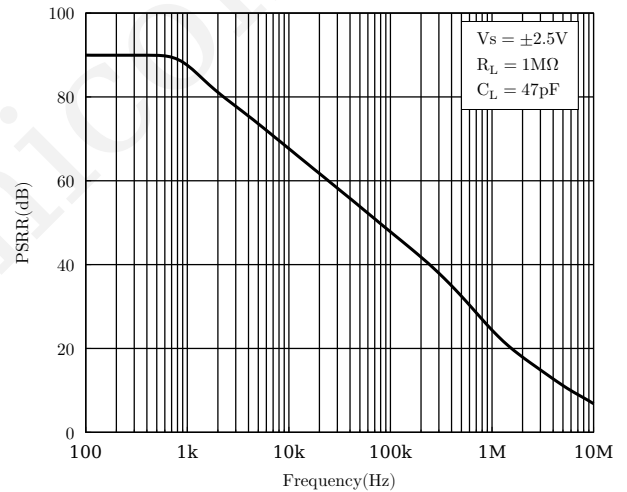
(a) 开环增益与相位 (1)



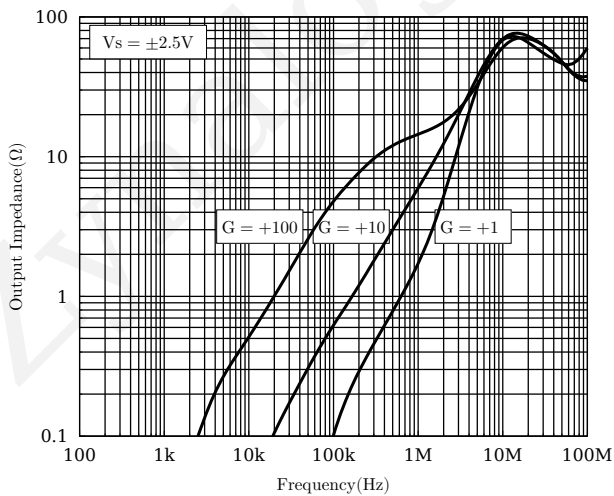
(b) 开环增益与相位 (2)



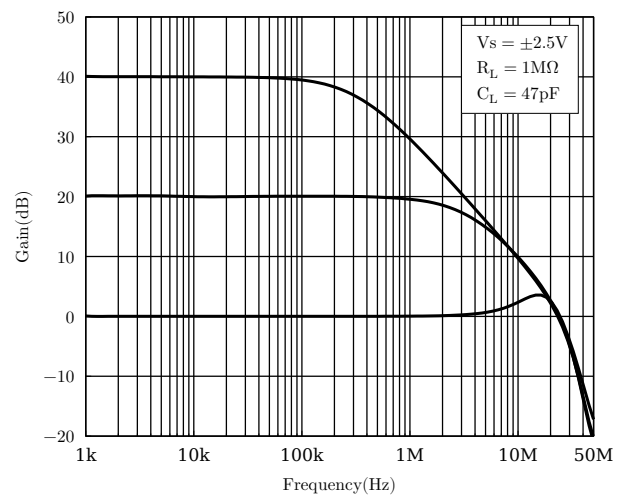
(c) 共模抑制比



(d) 电源抑制比

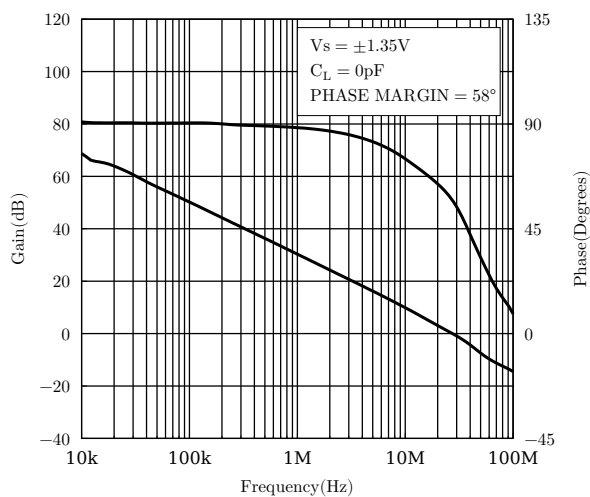


(e) 输出阻抗

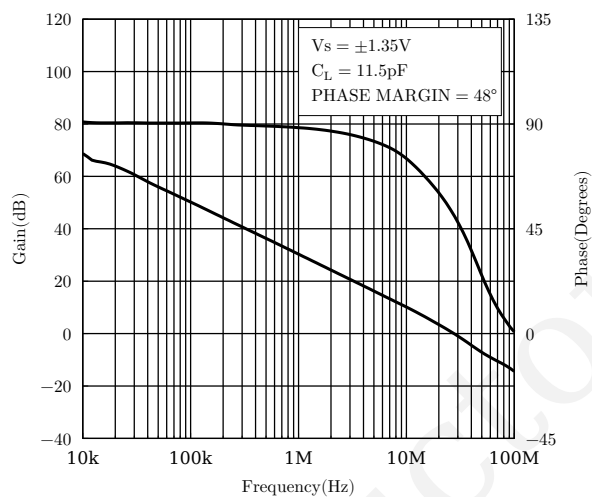


(f) 闭环增益

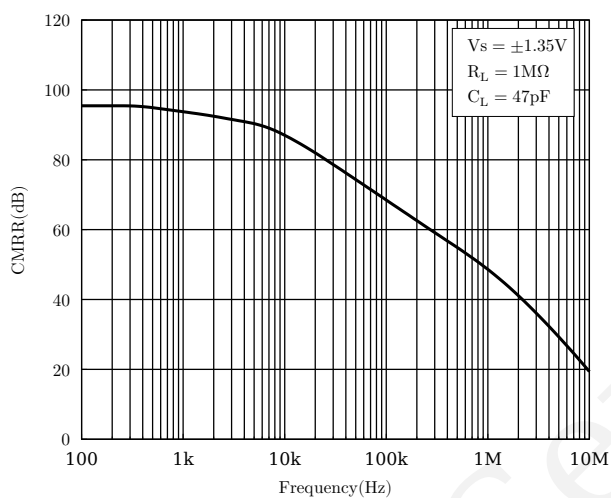
图 3: 性能特性 (1)



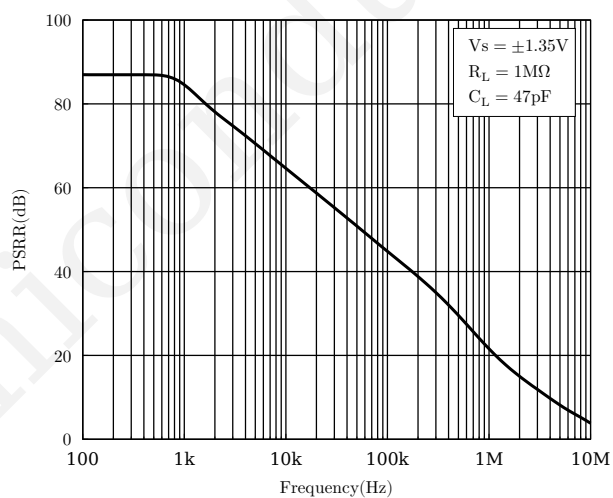
(a) 开环增益与相位 (1)



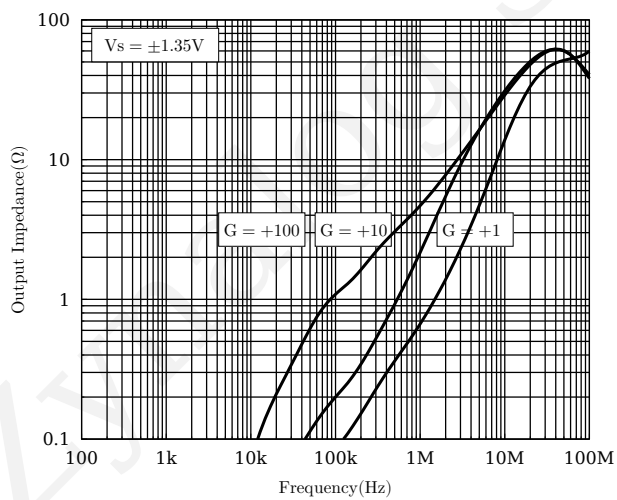
(b) 开环增益与相位 (2)



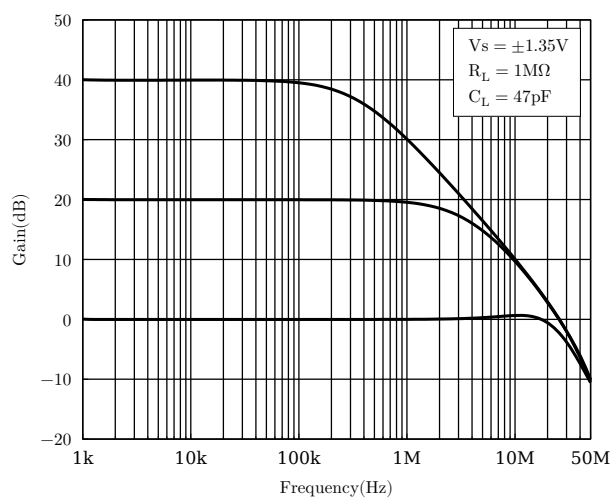
(c) 共模抑制比



(d) 电源抑制比

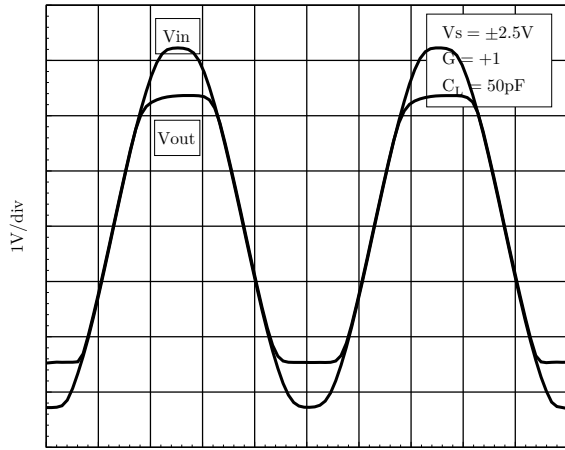


(e) 输出阻抗

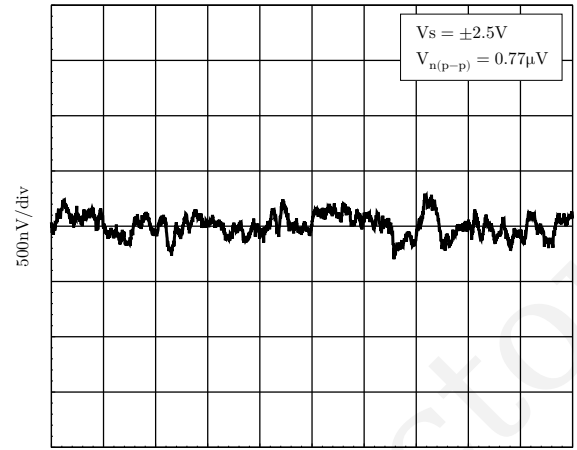


(f) 闭环增益

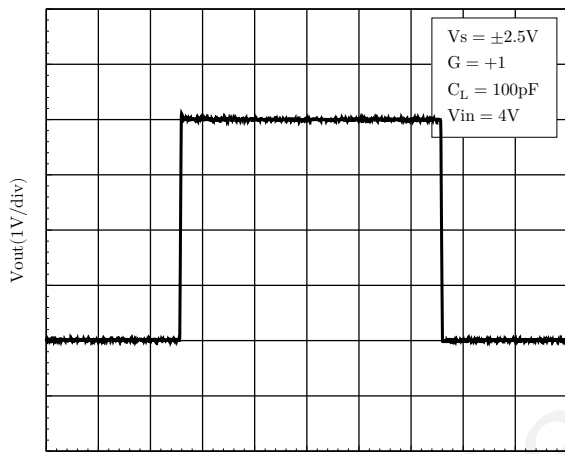
图 4: 性能特性 (2)



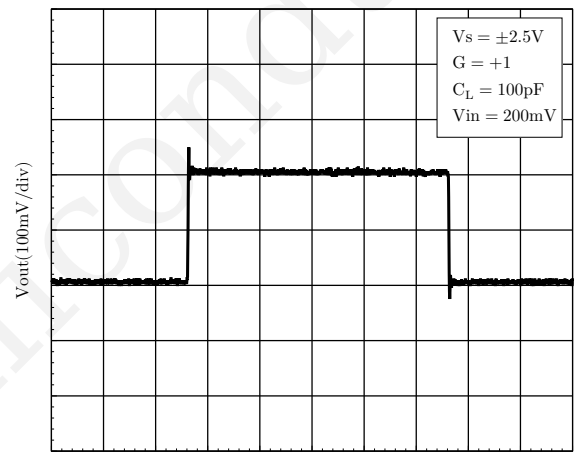
(a) 无相位反转



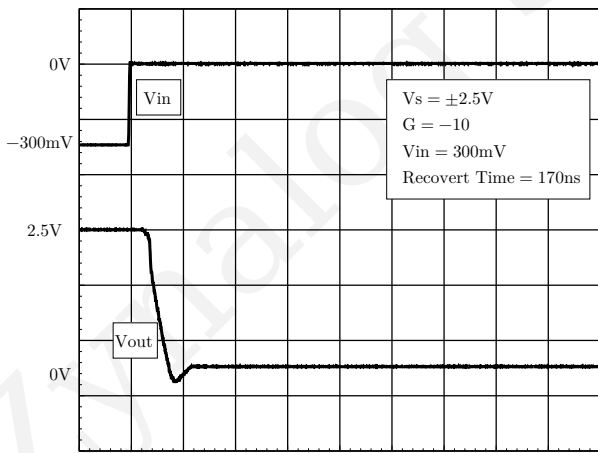
(b) 低频噪声 (0.1 Hz 至 10 Hz)



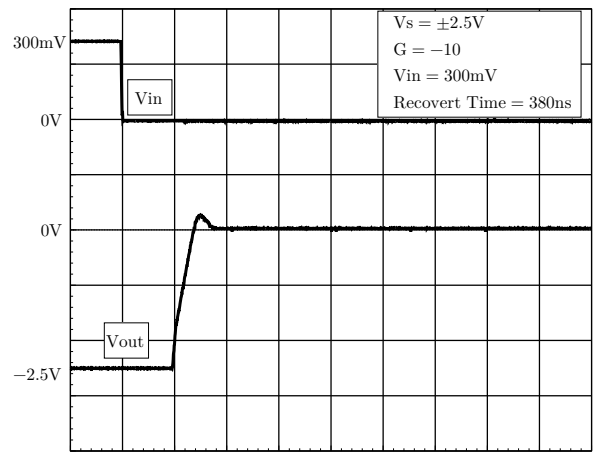
(c) 大信号响应



(d) 小信号响应



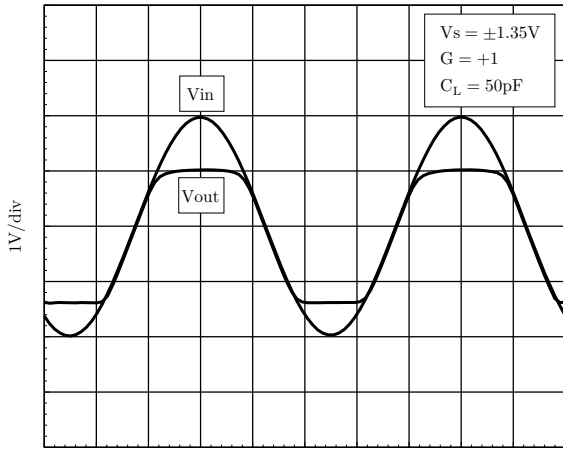
(e) 正过载恢复时间



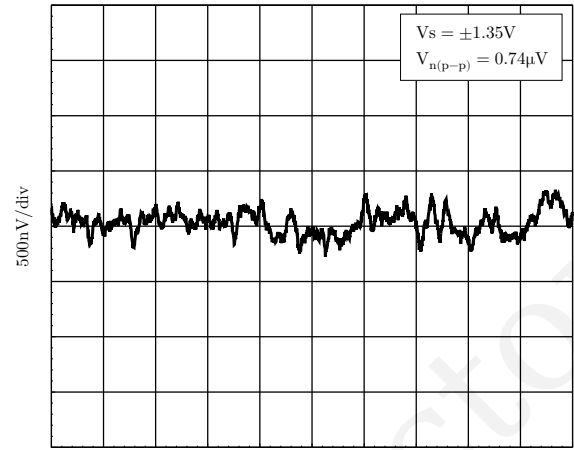
(f) 负过载恢复时间

图 5: 性能特性 (3)

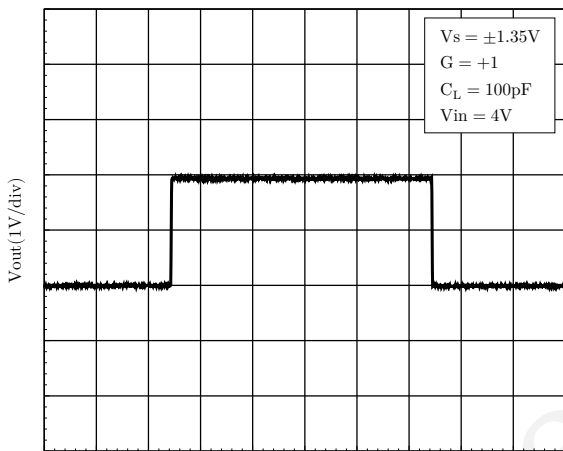




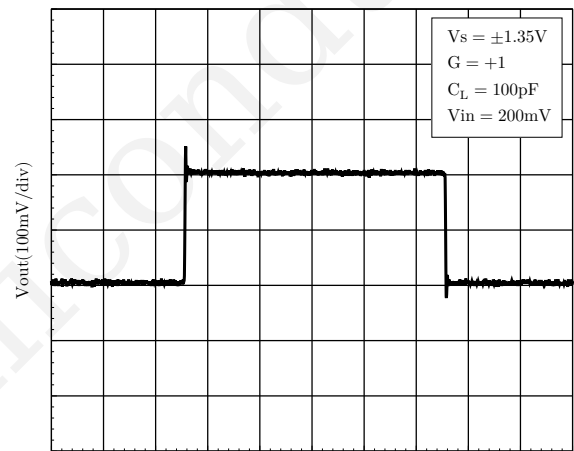
(a) 无相位反转



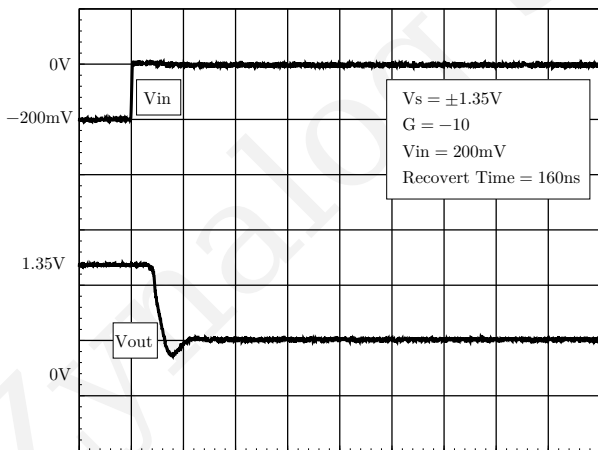
(b) 低频噪声 (0.1 Hz 至 10 Hz)



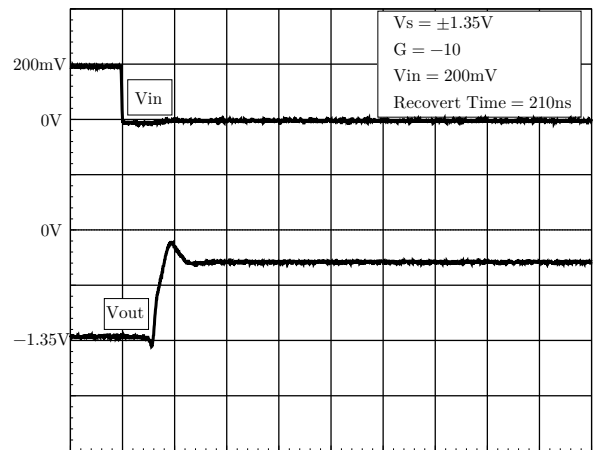
(c) 大信号响应



(d) 小信号响应

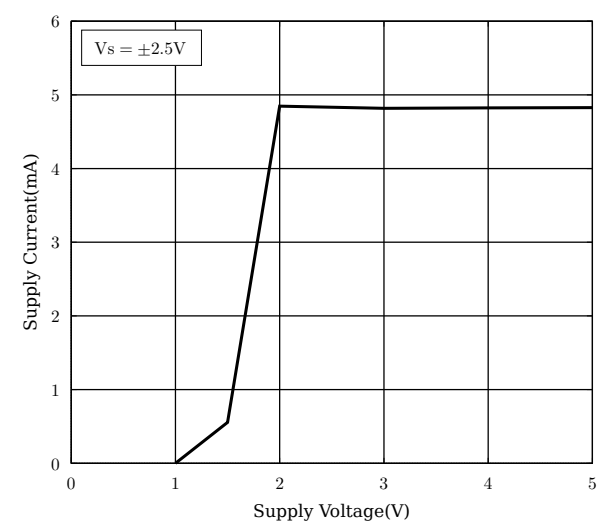


(e) 正过载恢复时间

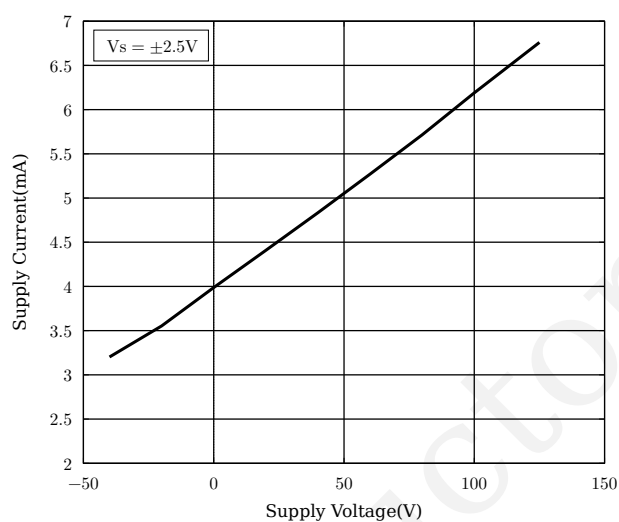


(f) 负过载恢复时间

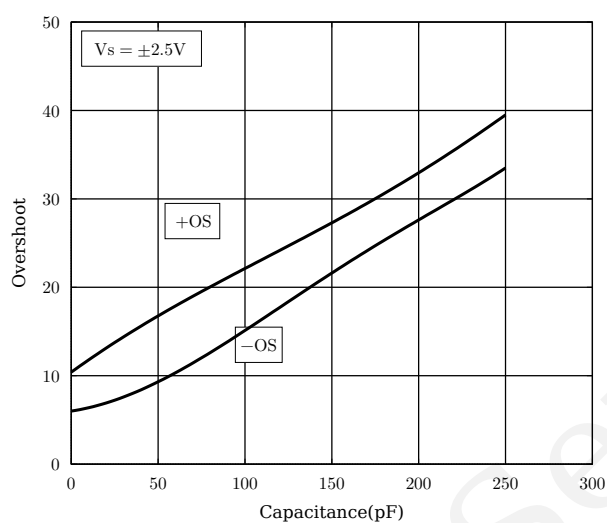
图 6: 性能特性 (4)



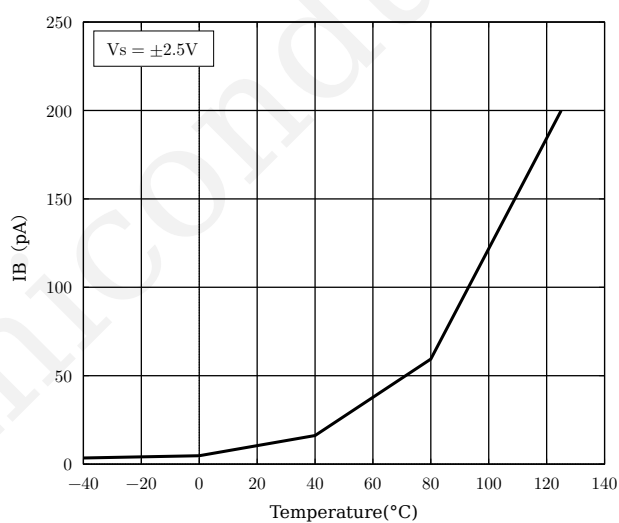
(a) 电流与电压



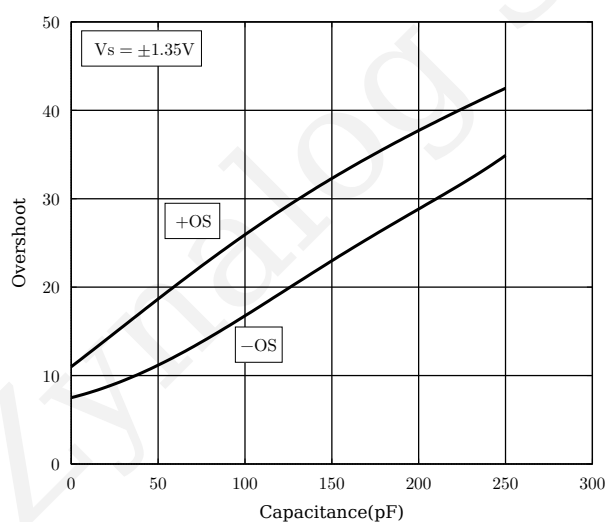
(b) 供电电流温漂



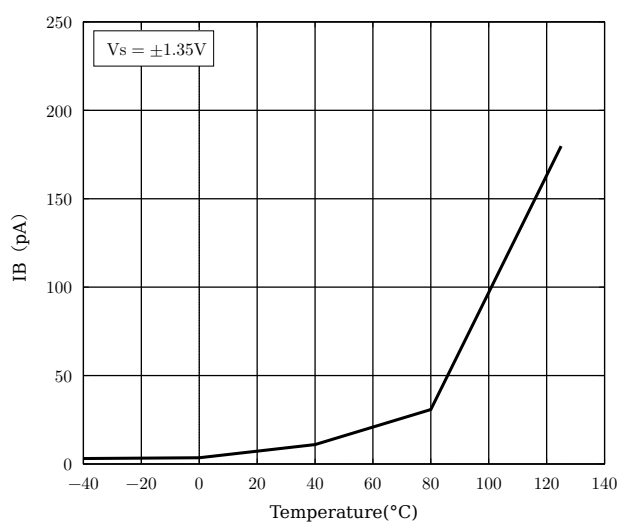
(c) 小信号过冲



(d) 偏置电流温漂



(e) 小信号过冲



(f) 偏置电流温漂

图 7: 性能特性 (5)

## 7 应用信息

### 7.1 输出相位反转

当放大器的输入由超过最大共模输入电压的电压驱动时，其输出端的极性会发生变化。这种现象可能会产生严重后果，可能对放大器造成不可逆的损坏，或导致反馈回路内的系统锁定。ZGA2001 在这方面表现出强大的性能，即使超过电源电压 2 伏以上，也不会出现相位反转。

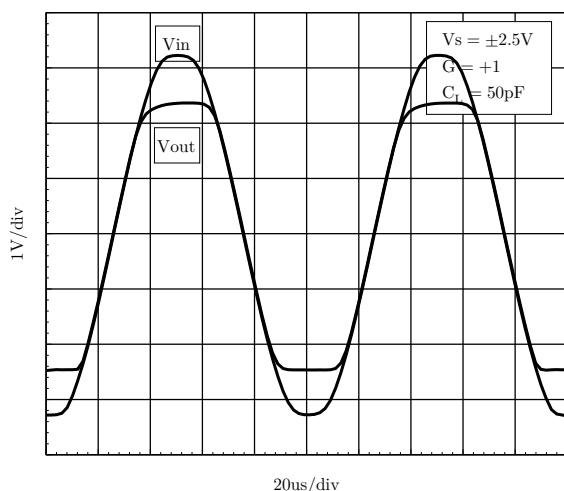


图 8: 无相位反转

### 7.2 输入电容

高速运放需注意旁路、接地及输入对地寄生电容。含阻性反馈时，总电容（源电容、引脚杂散电容、运放输入电容）会在噪声增益中引入极点，需在增益电阻并联补偿电容。当反馈电容使系统临界阻尼时，噪声增益高频段出现峰值。输入端数 pF 级电容会降低高频输入阻抗，导致增益升高引发频响峰值/振荡。

### 7.3 驱动容性负载

ZGA2001 可驱动 240pF 容性负载，但输入频率超过 100kHz 时（尤其是单位正增益配置）会产生显著振铃。推荐采用外部补偿技术：通过 RC 缓冲电路（见图 10）可将过冲降低 30% 以上并消除振铃，同时保持全增益输出稳定性。需注意该补偿无法恢复大容性负载导致的带宽衰减。

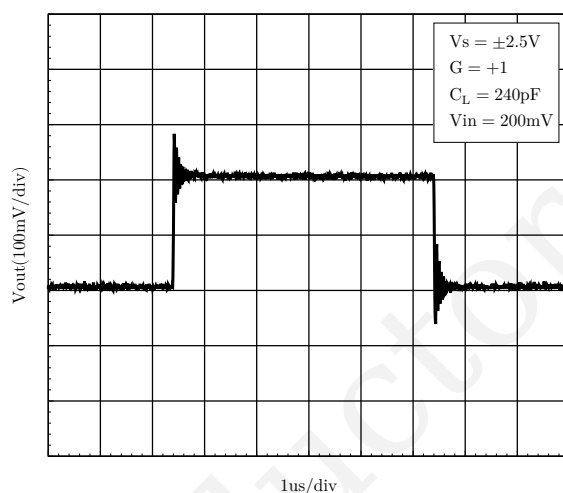


图 9: 无补偿驱动大容性负载

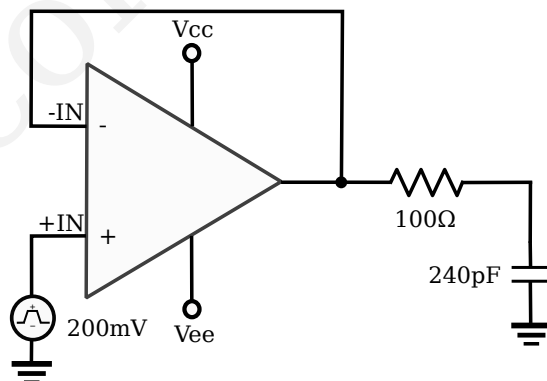


图 10: 缓冲器网络

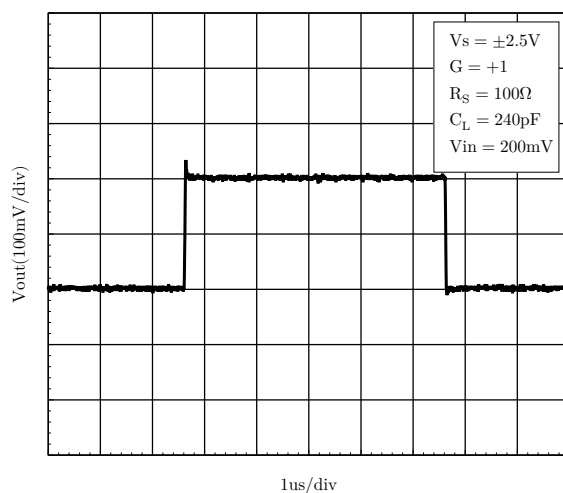


图 11: 使用缓冲器驱动大容性负载

## 7.4 布局指南

- **电源去耦与旁路电容:** 噪声可能通过电源引脚传入整个电路和运放的模拟部分。旁路电容通过为模拟电路提供本地低阻抗电源路径, 可有效抑制耦合噪声。建议在每个电源引脚与地之间就近连接低等效串联电阻的  $0.1\mu\text{F}$  陶瓷旁路电容。
- **模拟与数字地分离:** 分离模拟和数字电路的接地是抑制噪声最简单且有效的方法。如多层 PCB 中通常设置独立的地平面层, 以帮助散热并降低电磁干扰 (EMI)。
- **减少寄生耦合:** 输入走线应远离电源或输出走线。若无法完全隔离, 敏感走线应与噪声走线垂直交叉而非平行布线; 缩短输入路径, 将反馈电阻 ( $R_F$ ) 和增益电阻 ( $R_G$ ) 就近放置于反相输入端, 以最小化寄生电容。
- **关键信号防护:** 在敏感走线周围添加低阻抗驱动防护环 (Guard Ring), 可显著降低相邻不同电位走线的漏电流影响。
- **清洁与防潮:** 为了达到最佳性能, 建议在 PCB 组装完成后进行清洁; 精密集成电路可能因湿气渗入塑料封装导致性能偏移。完成水性清洁工艺后, 需对 PCB 组件进行低温烘烤, 以去除清洁过程中引入的湿气。

## 7.5 布局示例

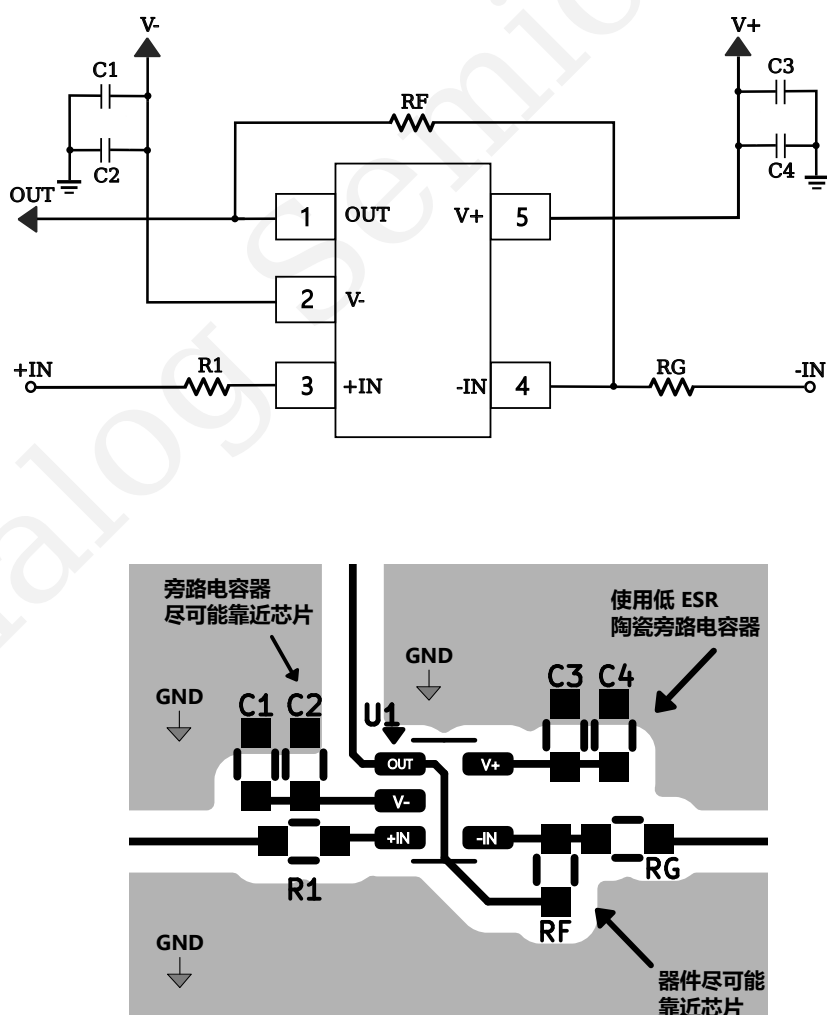


图 12: 布局示例

8 封装

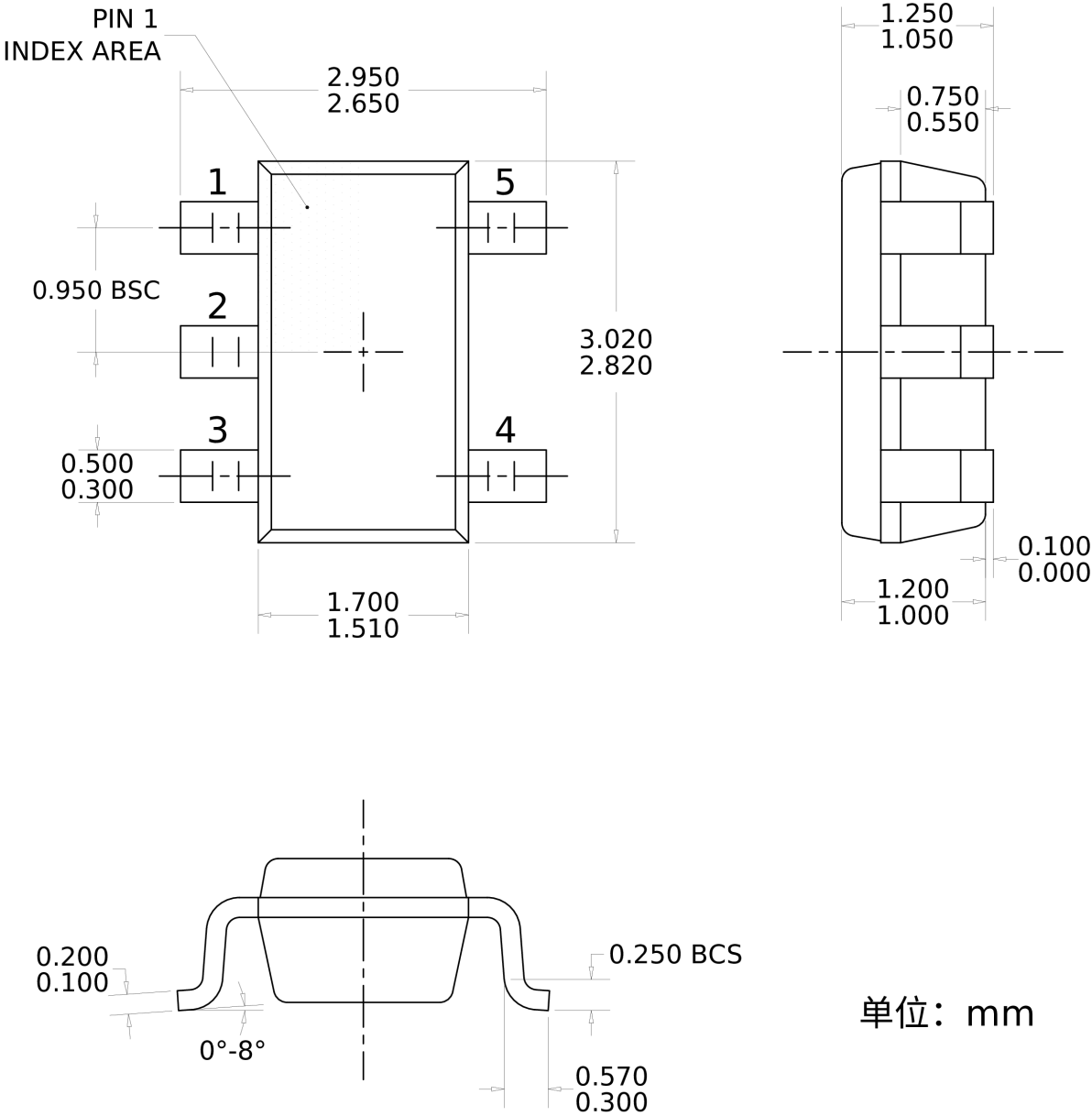


图 13: 封装信息

9 订购指南

型号	温度范围	封装描述	包装数	标识
ZGA2001G1	−40°C 至 +125°C	SOT23-5	3000	A2001

## 10 关于徵格

### 10.1 公司简介

徵格半导体【Zynalog Semiconductor Co.,Ltd.】是国内高性能模拟芯片研发设计的高科技企业。公司拥有国际顶尖的模拟芯片设计团队，先进的测试设备和完善的供应链体系，遵循严苛的品控标准，由公司全正向设计研发的三十多款高速高精度模数转换芯片（ADC）产品凭借卓越的高性能及高可靠性，已被国内多家头部知名科技企业所选用，完美应用于旗下各款高新产品之中。

徵格半导体秉持“技术自主创新，引领行业未来”的理念，以客户需求为导向，聚焦技术创新，坚持核心技术的长期研发投入，公司已在高性能模拟芯片领域拥有多项自主知识产权，ADC 多项核心技术指标已达到或超越国际主流同类产品。至此，徵格半导体已然定义和树立起国内高性能 ADC 行业新标杆。

当今中国，数字化和智能化将成为国内领先企业应对未来挑战的必由之路，为此徵格半导体将持续加码在高性能模拟芯片的研发进程，在“高性能芯片国产替代”成为确定性趋势和国家构建产业链供应链稳定安全的今天，我们将以客户技术变革和产业升级为指引，满足客户高科技产品应用的设计多样化及复杂化需求，灵活匹配客户产品的技术更迭和保障供应链的安全可靠，为客户提供全方位全流程模拟芯片标准解决方案。

徵格半导体将进一步拓展和深耕国内高性能模拟芯片应用端，实现以客户为中心的高速度高质量增长。公司将以前瞻性战略思维及雄厚的研发能力为基础，遵循严苛品控标准和安全可靠的供应链管理体系，与企业用户携手打造共创、共享、共赢的模拟芯片行业新生态。

### 10.2 联系方式

地址：上海市普陀区丹巴路 98 弄 7 号龙裕财富中心 10 层

地址：苏州市高新区城际路 21 号 2 幢汇融广场 2110 室

地址：杭州市临平区科城街 180 号算力小镇 C 幢 8 层

网站：<https://www.zynalog.com>

电子邮箱：[sales@zynalog.com](mailto:sales@zynalog.com)